



03BCK封装模组

03BCK是杏林睿光半导体AW系列多功能激光模组，TO封装光纤耦合输出，具有体积小、光斑均匀、功率稳定、高可靠性等特点。单模光纤接受定制。

主要功能特点

- ◆ 体积小
- ◆ 光斑均匀
- ◆ 可做单模输出产品
- ◆ 波长可选

应用

- 医疗美容
- 指示光
- 化学分析
- 激光加工

技术参数 (25°C)

封装形式		03BCK				
中心波长 (nm)		520		638	650	
光学	连续输出功率 $P_{op}(mW)$ ⁽¹⁾	2~10	60	150	130	2~10
	波长公差 (nm)	±10				
	光谱宽度 (FWHM) $\Delta\lambda$ (nm)	<6				
	波长随温度特性 $\Delta\lambda/\Delta T$ (nm/°C)	0.3				
电学	阈值电流 I_{th} (mA)	~50	170	75	80	~43
	工作电流 I_{op} (mA)	~75	300	280	260	~55
	工作电压 V_{op} (V)	6	6.2	3	2.4	2.2
	微分效率 η_{es} (W/A)	0.4	0.4	0.81	0.72	0.8
光纤	光纤芯径 D_{core} / 包层直径 D_{clad} (μm)	4/125, 6/125, 9/125			105/125	
	数值孔径 NA	0.14			0.22	
	光纤长度 L (cm)	100±10 (可定制)				
	连接器	FC/PC, ST, SMA905				

注：1. (1) 其它功率可接受定制。

2. 本系列产品可定制激光防反射功能。

3. 以上表格内所有数据均为室温25°C环境下测试所得的典型值，最终数据以出厂测试报告为准。

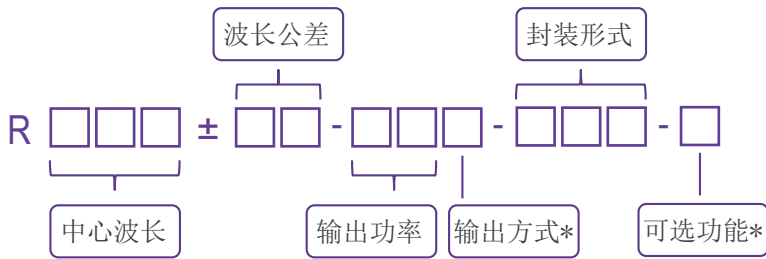
其他参数

参数	工作温度 (°C)	工作相对湿度 (%)	存储温度 (°C)	存储相对湿度 (%)	引脚焊接温度 (max/°C)
最小	10	-	-20	-	-
最大	30	75	70	90	250(10Sec.)

产品型号一览表

封装形式	波长 (nm)	功率 (mW)	型号
03BCK	520	2~10	R520±10-10mWF-03BCK
	520	60	R520±10-60mWF-03BCK
	638	150	R638±10-150mWF-03BCK
	650	2~10	R650±10-10mWF-03BCK
	650	130	R650±10-130mWF-03BCK

产品型号命名规则

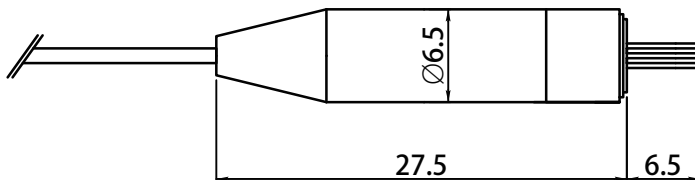


*输出方式: F - 光纤耦合输出

*可选功能: S - 单模

R - 防反800~1100nm

机械尺寸图 单位: mm



引脚	功能
1	激光器 (-)
2	外壳
3	激光器 (+)

注: 引脚定义以实际出厂数据为准

